

● USP-8B04パッケージ許容損失

USP-8B04パッケージにおける許容損失特性例となります。

許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

1.測定条件(参考データ)

測定条件：基板実装状態

雰囲気：自然対流

実装：Pbフリーはんだ

実装基板：銅箔4層基板76.2mm×114.3mm(片面約8700mm²)に対して銅箔面積

1層目：50mm×50mm_放熱板と接続有

2層目：70mm×70mm_放熱板と接続有

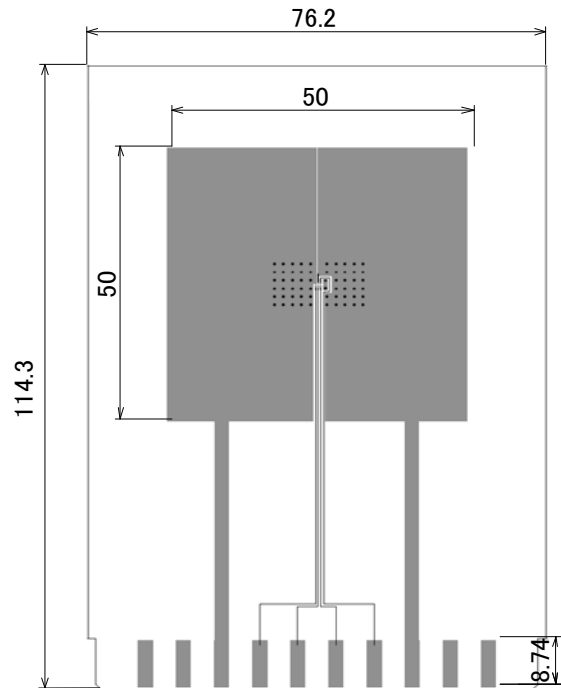
3層目：70mm×70mm_放熱板と接続有

4層目：50mm×50mm_放熱板と接続有

基板材質：ガラスエポキシ(FR-4)

板厚：1.6mm

スルーホール：φ0.2mm 60個/ φ0.3mm 12個



2.許容損失-周囲温度特性

基板実装($T_{jmax} = 125^{\circ}\text{C}$)

周囲温度(°C)	許容損失Pd(mW)	θ_{ja} (°C/W)	θ_{jc} (°C/W)
25	1000	100.00	11.90
85	400		

